

ニュースガイドNo, 10702

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中！ <http://www.itdc-patent.com>

\*最新の特許情報が満載！

## 貴金属メッキ方法と工程

[登録・公開編]平成23年(1年間) 69点

	(税込価格)	(本体価格)
全文PDF CD-ROM版(抄録版付)	¥21,000-	¥20,000-
全文紙収録 B5製本版	¥21,000-	¥20,000-
CD-ROM版・B5製本版 一括購入	¥31,500-	¥30,000-

### 既刊関連セットのご案内

No.	登録・公開	貴金属メッキ方法と工程	平.	点	(本体価格)
No,10567	登録・公開	貴金属メッキ方法と工程	平.22	70点	¥24,000
No,10429	"	"	平.21	72点	¥24,000
No,10293	"	"	平.20	78点	¥25,800
No,10157	"	"	平.19	88点	¥27,500
No,10047	"	"	平.18	89点	¥27,700
No,9920	"	"	平.17	84点	¥25,800
No,9787	"	"	平.16	87点	¥23,400
No,9642	"	"	平.15	76点	¥17,700
No,9443	"	"	平.14	76点	¥17,700
No,9255	"	"	平.13	74点	¥19,000
No,9036	"	"	平.12	66点	¥23,100
No,8811	"	"	平.11	76点	¥26,600
No,8592	"	"	平.10	75点	¥27,000
No,8087	公告・公開	"	平.8	66点	¥23,400
No,7949	"	"	平.7	72点	¥25,300
No,8503	"	装飾用パラジウムメッキ方法	平.5-平.9	53点	¥20,700
No,8497	"	ハードディスク用基板のメッキ方法	平.5-平.9	66点	¥27,800
No,8298	"	ノン・シアン・メッキ方法と浴の組成	平.1-平.8	68点	¥29,700
No,8295	"	メタルアレルギー防止メッキ方法	平.5-平.8	62点	¥26,800

\*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: [kokusai@itdc-patent.com](mailto:kokusai@itdc-patent.com))

お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしおりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。

2～3日中に請求書同封の上お送り致します。]

### お 申 込 書

会社名	ご注文内容	
	ニュースガイドNo.	
	CD-ROM版 or B5製本版 or 一括購入	
所属部署名	題名	
	合計 ¥	
担当者名	E-mail:	
	TEL:	FAX:
住所:〒		

料金には別途送料がかかります。

# 貴金属メッキ方法と工程

No.10702

[登録・公開編] 平成23年(1年間) 69点

CD-ROM版 ¥21,000 B5製本版 ¥21,000 (全て税込価格)

( CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥31,500 )

1 耐食材及びその製造方法	株式会社フルヤ金属	30 ステンレス基板への金めっきパターン の形成方法	大日本印刷株式会社
2 メッキ装置およびメッキ方法	DOWAメタルテック株式 会社	31 金属めっき液添加剤及び金属めっき 方法	三洋化成工業株式会社
3 プリント配線板の製造方法	パナソニック株式会社	配線基板用積層体、配線基板、配線 32 基板用積層体の製造方法、及び配線 基板の製造方法	旭化成イー・マテリアルズ株 式会社
4 白色被膜を有する装飾品	シチズンホールディングス 株式会社	33 水素気体分離用パラジウム合金複合 膜の製造方法	韓国エネルギー技術研究 院
5 配線基板の製造方法	凸版印刷株式会社	34 Fe Pt合金めっき方法およびFe Pt合 金めっき液	国立大学法人信州大学
6 差厚めっきの製造方法およびこれに用 いる差厚めっきの製造装置	パナソニック株式会社	35 回路基板用電気コネクタ	ヒロセ電機株式会社
7 表面処理方法およびそれを用いる電 子部品の製造方法	株式会社シミズ	36 導電性組成物および電気化学反応方 法および構造体	独立行政法人産業技術総 合研究所
8 リードフレームのめっき方法	株式会社三井ハイテック	37 導電性組成物を用いた構造体の作製 方法および構造体	独立行政法人産業技術総 合研究所
9 パンプ形成用非シアン系電解金めっき 浴	エヌ・イーケムキャット株式 会社	38 超精細ノズル及びその製造方法	株式会社ルス・コム
10 金パンプ又は金配線の形成方法	エヌ・イーケムキャット株式 会社	39 毒性金属を使用することなく電気めっ き法により黄色の金合金析出物を得る 方法	ザ・スウォッチ・グループ・リ サーチ・アンド・ディベロッ PMENT・リミテッド
11 金めっき液および金めっき方法	国立大学法人信州大学	40 ステンレス基板への金めっき層の形成 方法およびそれに用いるめっき装置	大日本印刷株式会社
12 電解金めっき液及びそれを用いて得ら れた金皮膜	日本高純度化学株式会社	41 めっき部材およびその製造方法	DOWAメタルテック株式 会社
13 パラジウム錯塩及びパラジウム又はそ の合金の一つを析出させる電解浴の パラジウム濃度を調節するための...	メタロール テクノロジー フ ランス エス アー エス	42 電解質組成物	ショット・ゾラール・アーゲー
14 改善されたメッキ方法	ローム・アンド・ハース・エレ クトロニック・マテリアルズ, エル・エル・シー	43 半導体集積回路装置の製造方法	ルネサスエレクトロニクス株 式会社
15 金属針構造体及びその製造方法	学校法人早稲田大学	44 めっき液、めっき膜、装飾品および時計	セイコーエプソン株式会社
16 プリント配線板の製造方法、及び半導 体チップ搭載基板の製造方法	日立化成工業株式会社	45 装飾品の製造方法、装飾品および時計	セイコーエプソン株式会社
17 パラジウム又はその合金を電気化学的 に析出させるための電解浴	メタロール テクノロジー フ ランス エス アー エス	46 コンタクトプローブ	理化電子株式会社
18 艶消し金属層を堆積するための電解 液および工程	エントン インコーポレイテ ッド	47 電解硬質金めっき液及びこれを用いる めっき方法	エヌ・イーケムキャット株式 会社
19 複合めっき材の製造方法	国立大学法人 熊本大学	48 メッキ構造及び電気材料の製造方法	協和電線株式会社
20 メッキ膜作製方法及び該方法によるメッキ 膜を備えたメッキ製品	学校法人 名城大学	49 抗置換硬質金組成物	ローム・アンド・ハース・エレ クトロニック・マテリアルズ, エル・エル・シー
21 改善された金合金電解質	ローム・アンド・ハース・エレ クトロニック・マテリアルズ, エル・エル・シー	50 可動接点用銀被覆ステンレス条及びこ れを用いたスイッチ	古河電気工業株式会社
22 部分めっき方法およびコネクタ端子なら びにコネクタ端子の製造方法	株式会社オートネットワーク 技術研究所	51 リードフレーム	株式会社三井ハイテック
23 めっき物の製造方法及び電気めっき 方法	旭鍍金株式会社	52 マイクロ構造体の製造方法および放射 線用吸収格子	キヤノン株式会社
24 微小構造体、ドナー基板、及び微小構 造体の製造方法	富士ゼロックス株式会社	53 微細構造体の製造方法	キヤノン株式会社
25 端子接続部の表面被膜構造及びその 形成方法	新光電気工業株式会社	54 マイクロ構造体の製造方法および放射 線吸収格子	キヤノン株式会社
26 電極形成用金めっき浴及びそれを用 いた電極形成方法	エヌ・イーケムキャット株式 会社	55 貴金属物品及びその製造方法	三菱マテリアル株式会社
27 電解硬質金めっき液及びこれを用いる めっき方法	エヌ・イーケムキャット株式 会社	56 亜硫酸金めっき液を用いた金めっき方 法	日本エレクトロプレイティン グ・エンジニアーズ株式 会社
28 連続部分めっき装置及びそれを用い た連続部分めっき方法	三友セミコンエンジニアリン グ株式会社	57 半導体装置用リードフレームとその製 造方法	パナソニック株式会社
29 導電部材及びその製造方法	三菱伸銅株式会社		以下12点省略